

Embedded world 2019 Nyheder og trends

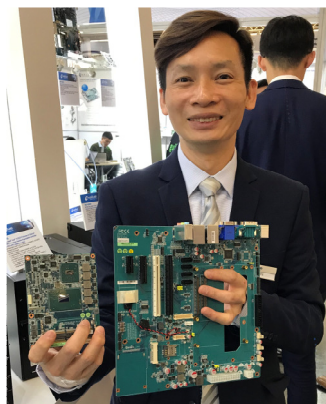
Modulære Markedstrends og produkt nyheder fra Embedded World i Nürnberg 2019

Mange spændende, nye produkter blev præsenteret på Embedded World i Nürnberg i år. Et markant område var indenfor 2D og 3D ansigtsgenkendelse og identifikation af køretøjstyper. Automatisk udregning af pakkestørrelser og rumfylde på totalforsendelser var også på agendaen.

En klar tendens hos producenterne er, at mere og mere blive modulære komponenter. Formfaktoren og tilslutninger på det modul, der kommer i kontakt med hovedproduktet fastholdes, og et nyt opdateret modul med de ønskede opdateringer sættes til.

M-Comp A/S er opbygget på og omkring et modulært koncept, da det giver de største muligheder – også for opdateringer og customization i kundernes projekter.

Indenfor Storage & Memory går tendensen mod fysisk mindre og hurtigere moduler med større kapacitet. Holdbarheden ved høj varme, som mange efterspørger får også stort fokus. Vores partner, Innodisk, har udviklet en "Fire Shield SSD", som kan klare 800 grader C



En ny trend på Dram er 2666 Mhz memory moduler, og på Flash kommer der en 96 lags QLC 3D.

Kontakt Peter Linnet på pl@m-comp.dk eller tlf. +45 9669 5000 for mere information.

M·COMP
Bring components to life